

114學年度課程規劃表

半導體工程與材料系

碩士在職專班

第一學年(114)						第二學年(115)					
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
院必修	專題討論	1	2	1	2	院必修					
	研究方法與論文寫作			1	2						
	小計	1	2	2	4		小計	0	0	0	0
專業必修						專業必修	論文	3	3	3	3
	小計	0	0	0	0		小計	3	3	3	3
專業選修	高等物理冶金	3	3			專業選修	半導體化學材料應用及檢測	3	3		
	半導體元件導讀	3	3				奈米封裝技術	3	3		
	高等高分子化學	3	3				先進半導體技術	3	3		
	陶瓷材料特論			3	3		電子顯微鏡學			3	3
	薄膜工程導論			3	3		專利檢索與寫作			3	3
	電化學分析技術與應用			3	3		光譜分析			3	3

【科目類別】

專業科目：院必修、專業必修、專業選修

【科目類別】		學分	時數
專業科目	院必修	3	6
	專業必修	6	6
	專業選修	21	21
合計		30	33

【注意事項】

1. 最低畢業學分：30學分，其中專業選修21學分(本系至少15學分，其餘可跨系)。
2. 每學期修習學分：下限為1學分。
3. 「論文」必修6學分，俟口試通過後，一次給予6學分。
4. 表列專業選修課程，得依實際情況逕行調整。
5. 本表建立於114年2月13日

應材系主任龍明有



半導體學院院長張合